

证券代码：603061

证券简称：金海通

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2024-009

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 投资者关系活动类别   | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场访谈<br><input type="checkbox"/> 其他                   | <input type="checkbox"/> 线上分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input checked="" type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 线上调研 |
| 参与单位名称      | 华泰柏瑞基金、财通基金、国金证券、浦银安盛、汇丰晋信、中信保诚、太平基金、安信基金、东吴基金、兴合基金、国泰君安资管、深圳前海登程资管、上海汐泰投资、禾浦私募、趣时资产、泉果基金、深圳正圆投资、青骊投资、光大证券、易方达、招商基金、太平资产、星石投资、华泰国际私募、LyGH Capital 立格资本、国信钧翎投资、华泰证券、平安养老、誉辉资本、卫宁私募、钦沐资产、工银瑞信、建信基金（以上排名不分先后） |  |
| 时间          | 2024年6月4日至2024年6月6日  |  |
| 地点          | 现场访谈：上海市青浦区嘉松中路2188号<br>路演活动：上海市浦东新区世纪大道88号、上海市浦东新区陆家嘴环路1333号、上海市浦东新区富城路33号<br>线上调研：腾讯会议   |  |
| 上市公司接待人员姓名  | 副总经理兼董事会秘书刘海龙先生  |  |
| 投资者关系活动主要内容 | <b>一、公司介绍主要内容</b><br>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，  |  |

|              |  |
|--------------|--|
| <p>要内容介绍</p> | <p>客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，始终坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。</p> <p>公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。</p> <p><b>二、公司 2023 年年报及 2024 年第一季度业绩概况</b></p> <p>2023 年，全球电子产品市场需求疲软，集成电路行业处于下行周期，半导体封装测试企业、测试代工厂等设备需求趋缓，公司 2023 年实现营业收入 3.47 亿元，较上年同期减少 18.49%。</p> <p>受毛利率较上年同比下降，研发费用、管理费用等费用较上年同比增长等因素影响，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8479.41 万元，较上年同比减少 44.91%。</p> <p>公司销售的测试分选机产品有 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列及其他系列等，各系列产品具有多种型号，同时公司提供了多种选配功能，销售价格存在一定差异；2023 年受市场需求下行等影响，公司产品销售结构较上年发生变化，功能配置较低的机型占销售收入的比重较 2022 年有一定程度的提升；同时，公司部分产品采用委托外协的方式进行生产加工导致成本略有提高；因此，公司 2023 年毛利率较上年同比下降。</p> <p>研发方面，2023 年，公司持续增加研发投入，为产品创新和公司竞争力提供保障。2023 年，公司研发费用较上年同比增长 25.09%。同时，公司持续引进研发人员并加强人才培养，2023 年末，公司研发人员数量较 2022 年末增长 20.41%。</p> |
|--------------|--|

产品方面，一方面，公司持续升级现有产品，持续跟进客户需求，不断对现有产品在温度控制、并测工位、芯片尺寸、上下料方式和压力控制等各方面进行技术研发和产品迭代；另一方面，公司也积极布局新产品，公司此前推出的 EXCEED-9000 系列产品是在 EXCEED-6000、EXCEED-8000 系列基础上对整个平台的升级，其中的 EXCEED-9800 系列是针对三温测试需求的升级产品。针对 EXCEED-9800 系列产品，2023 年公司积极推进在广泛的客户端进行试用，积极配合客户的进一步需求。同时，公司也在积极推进适用 Memory 和 MEMS 及专用于先进封装产品的测试分选平台的研发工作。

公司募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”2023 年内已完成土地使用权购置、筹备开工等相关工作，目前正稳步推进。本项目建设周期 3 年，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。

市场推广方面，2023 年，公司持续加大市场推广力度，积极拓展境内、境外新客户，与客户保持紧密沟通，积极参加展会等行业相关活动。公司 2023 年度销售费用较上年同期增长 17.48%。同时，公司持续提升自身的客户服务能力，加强境内、境外销售及售后团队管理，以提高客户服务效率，完善客户服务体系。2023 年 6 月，公司启动“马来西亚生产运营中心”项目，该项目拟建立在东南亚地区具有全面服务客户的生产能力和应用能力的生产运营基地，从而更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展。截至目前，“马来西亚生产运营中心”项目正处于厂房装修阶段。

截至 2023 年年末，公司总资产达 15.85 亿元，较上年末增长 93.97%；净资产为 13.99 亿元，较上年末增长 140.05%。总资产、净资产同比有较大幅度上涨是因为公司于 2023 年 3 月首次公开发行股票并在上海证券交易所上市所导致。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 8856.35 万元，较 2023 年第一季度同比减少 12.79%；较 2023 年第四季度环比增加 12.72%。实现归属于上市公司股东的净利润 1489.26 万元，较 2023 年第一季度同比减少 53.31%，较 2023 年第四季度环比减少 53.57%。

截至 2024 年一季度末，公司总资产达 14.19 亿元，较 2023 年年

末减少 10.50%；净资产为 12.54 亿元，较 2023 年年末减少 10.32%。

### 三、调研问答

1、问：公司所在行业格局如何？同行业公司有哪些？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。集成电路测试分选机属于集成电路专用设备领域的测试设备。公司自成立以来深耕集成电路测试分选机领域，经过多年的研发和创新，公司产品的主要技术指标及功能已达到同类产品国际先进水平。

公司所在行业是充分竞争的全球化市场。目前，全球集成电路测试分选机行业内，除公司外，主要有美国科体半导体公司（Cohu, INC.）、日本精工爱普生公司（Seiko Epson Corporation）、日本爱德万测试集团（Advantest Corporation）、中国台湾鸿劲精密股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司等企业。

2、问：决定购买测试分选设备的是芯片设计公司还是测试代工厂？

答：两种情况都有，具体要看产品和项目情况。一般而言，测试代工厂的话语权会相对多一些。但是对于芯片设计公司有特别测试需求的产品如算力芯片等，芯片设计公司主导测试分选设备的评估，在这种情况下，芯片设计公司通常会直接或者通过测试代工厂与公司沟通设备技术指标等需求。

3、问：国内封测厂扩产用国产产品的意愿高吗？

答：公司受益于国内半导体行业的快速发展。

公司所在行业是充分国际化竞争的行业。公司自成立以来，一直以国际市场需求为导向，坚持“国际化定位”，以技术创新为动力，以成为“全球测试分选行业领先者”为目标，这一定位将在未来长期坚持。

公司目前在马来西亚、新加坡等地设有境外经营主体或办公室等。在国际化市场战略的背景下，公司境内经营主体协同境外经营主体或办公室面向半导体产业发达的国家和地区进行持续性、常态化的市场

开拓及售后服务。

4、问：公司 2023 年海外业务的情况如何？公司 2024 年海外业务的预期如何？

答：2023 年，公司实现营业收入 3.47 亿元，其中来自境外的营业收入占营业收入总额的比重约为 18%。

公司自成立以来就坚持国际化市场路线，公司产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。随着半导体产品的升级换代，对测试分选机不断提出新的技术升级要求，公司也在持续跟进客户对测试分选机的升级迭代要求。

公司目前在马来西亚、新加坡等地设有境外经营主体或办公室等。在国际化市场战略的背景下，公司境内经营主体协同境外经营主体或办公室面向半导体产业发达的国家和地区进行持续性、常态化的市场开拓及售后服务。

2023 年 6 月，公司启动“马来西亚生产运营中心”项目，该项目拟建立在东南亚地区具有全面服务客户的生产能力和应用能力的生产运营基地，从而更好地贴近市场和客户、响应客户需求，促进公司稳健经营和持续发展。截至目前，公司“马来西亚生产运营中心”项目正处于厂房装修阶段。

2024 年，公司在积极开拓境内市场的同时，将重点跟进境外头部 IDM、OSAT 以及设计公司等头部企业快速迭代的产品及测试分选需求，持续增强公司在境外市场的市占率及单个客户的渗透率。

5、问：订单能见度如何？

答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。对于定制化需求较高的客户，公司通常会与客户保持长期深入的技术交流和商务沟通。

6、问：今年有新的平台（项目）在研发吗？

答：产品方面，2024 年公司将进一步跟进三温测试设备的定制化

|              |  |
|--------------|--|
|              | 需求，持续加强针对新能源、电动汽车及 AI 运算等相关领域芯片测试分选的技术研发，继续加大对适用于 Memory、MEMS 及专用于先进封装产品的测试分选平台的研发力度。同时，公司也将积极布局重点关注的技术方向，截至目前公司已参股投资了 1 家晶圆级测试分选设备公司。 |
| 附件清单<br>(如有) | 无  |
| 风险提示         | 以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。  |
| 日期           | 2024 年 6 月 6 日   |